

株式の状況

株式数及び株主数		(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数	7,800,000株	
発行済株式総数	3,909,800株	
株主数	1,661名	

大株主			(2025年3月31日現在)
	持株数(株)	持株比率(%)	
株式会社アルゴグラフィックス	1,980,000	50.6	
セイコーインスツル株式会社	816,000	20.9	
ジーダット従業員持株会	55,400	1.4	
MSIP CLIENT SECURITIES	43,900	1.1	
久保田 正明	40,000	1.0	
若林 敬三	28,000	0.7	
株式会社エスケーエレクトロニクス	18,000	0.5	
大日本印刷株式会社	18,000	0.5	
柿木 利彦	17,600	0.5	
今井 日出樹	15,600	0.4	

所有者別状況			(2025年3月31日現在)
所有者区分	持株数(株)	持株比率(%)	
金融機関	9,700	0.3	
証券会社	33,561	0.9	
その他国内法人	2,843,215	72.7	
外国法人等	90,622	2.3	
個人・その他	872,230	22.3	
自己名義株式	60,472	1.5	
計	3,909,800	100.0	

株主メモ	
上場市場	東京証券取引所 スタンダード市場
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 (https://www.jedat.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

株式事務のお問い合わせ先	
住所変更、株式配当金受取り 方法の変更及び マイナンバーのお届出などの お問い合わせ	お取引の証券会社等になります。
未払配当金、その他当社株式 関係書類についてのお問い合 わせ	みずほ信託銀行 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
株主総会資料の電子提供制度 (書面交付請求) についてのお問い合わせ	お取引の証券会社またはみずほ信託銀行へお問い合 わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
株式等に関するマイナンバー のお届出のお願い	・株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナン バーのお届出が必要です。 ・お届出が済んでいない株主さまは、上記お問い合 わせ先へマイナンバーのお届出をお願いします。

表紙の絵は、江戸時代に歌川広重が描いた鐵砲洲の情景です。江戸の入り口として日本の全国各地から廻船が集まった歴史あるこの地から、JEDATは日本EDAの最先端技術を世界へ発信いたします。



本社 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel：03-6262-8400 (代)
当冊子に関するお問い合わせ先 株式会社ジーダット 経営管理本部 E-mail：corporate.planning1@jedat.co.jp



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



株式会社ジーダット

証券コード:3841

第23期 株主通信

自2024年4月1日 至2025年3月31日



歌川広重「鉄砲洲側真景」国立国会図書館所蔵



JEDAT は Japan EDA Technologies の略です。

私たちは、日本の EDA のリーダーとして、
電子産業の発展に貢献したいと考えています。

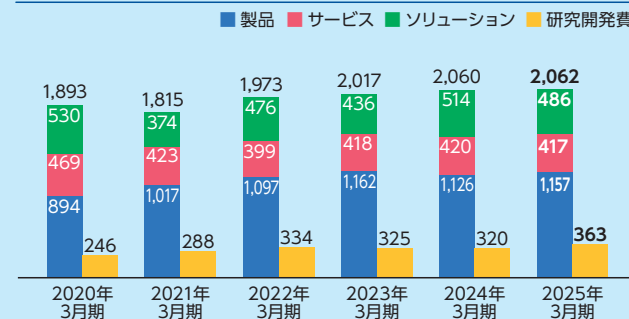
EDA とは Electronic Design Automation の略です。

電子機器や電子部品の設計作業を支援、検証するソフトウェア（電子系 CAD）で、
設計作業には不可欠なツールであり、設計期間の短縮や設計品質の向上を実現します。

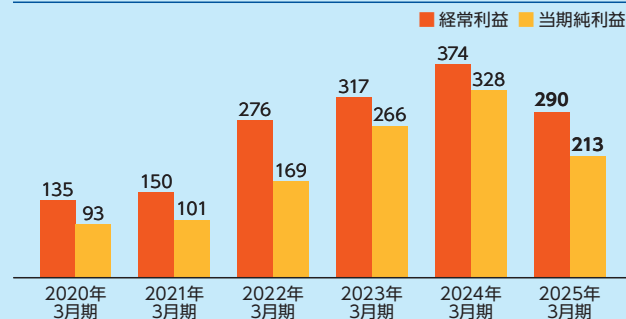
財務ハイライト

(単位：百万円)

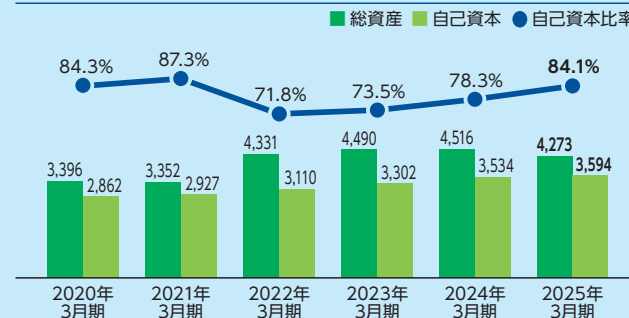
売上高・研究開発費



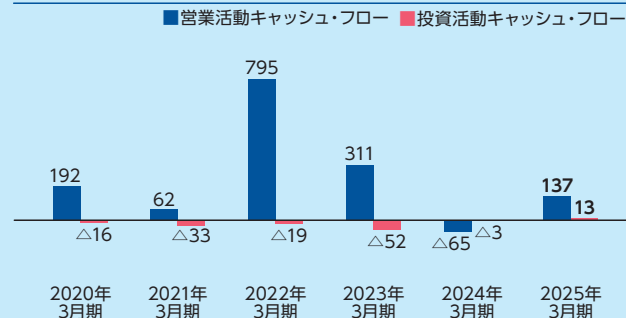
経常利益・当期純利益



総資産・自己資本



キャッシュ・フロー



ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当第23期における当社の売上高は、半導体市場低調の中で前年並みの売上を確保し、前年比0.1%増となる20億62百万円、営業利益は人材への投資による固定費の増加等により前年比14.9%減の2億56百万円となりました。

当事業年度における主な当社の活動といたしましては、主力製品：SX-MeisterのVer.18.0をリリース、アナログLSI設計の自動化に向けた機能拡張と、パワー半導体設計向けツールの機能強化を実現しました。7月には、かねてより取り組みを進めてまいりましたTSMC Open Innovation Platform® EDA Allianceへの加入が実現、秋に開催された「OIP Ecosystem Forum」にも出展し、当社技術を広くご紹介いたしました。また仏XYALIS社、同じく仏POLLEN社と国内販売代理店契約を新たに締結し、両社の競争力のある製品の販売が可能になりました。



代表取締役社長

松尾和利

当社の主要顧客である電子デバイス業界の状況は、半導体関連においてはAI関連デバイスへ高い期待が寄せられており、スマートフォン・パソコン等向けの半導体デバイスの需要は低調な一方で、パワー半導体のEV化は減速、再エネ・民生品等の需要は好調に推移しております。

対して、FPD（Flat Panel Display etc.）関連におきましては、製品のコモディティ化によって設計ツール需要が縮小する傾向が加速しております。また、米国トランプ政権の関税政策による景気後退感の高まりや、依然として継続する中国市場の低迷等の地政学的な懸念材料により、先行きに対する不透明感は依然として強いものがあります。

そのような中で当社は、引き続きコア製品の競争力・販売力を強化すべく、アナログLSI設計自動化環境（ACC）の拡張、パワーデバイス向け設計効率化機能の拡張、AIを用いたアナログ合成ツールの製品化、といった重点テーマに向けた開発を継続してまいります。研究開発活動におきましては、デバイス設計部門との連携強化により設計者目線の製品づくりを進め、平行して外部技術の導入・活用を促進いたします。また、販売促進活動におきましては、新規リリース製品の販促、情報発信活動の促進に加え、大学、高専、企業との連携を強化してまいります。

売上拡大に向けた施策としては、海外の半導体市場に対して、大規模フォトマスクデータブラウザ「HOTSCOPE」の販促強化に加え、「プラットフォーム戦略」の推進を図ってまいります。また、カスタムソフトウェアビジネスの拡張にあたっては、デバイス製造装置メーカーとの連携を深めるとともに、半導体後工程分野への進出を検討しております。さらに、デバイス設計受託サービスの拡大に向けては、受託可能な設計量の増強に加え、国内外における新規顧客の開拓・拡充、そしてSX-Meisterを活用した設計・コンサル型の提案を実現してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

特集 営業本部 営業企画部長に聞く

TSMC OIP EDA Allianceへの加入と今後の展開

2024年7月、ジエダットは、TSMCのOpen Innovation Platform[®]（以下、OIP）でのEDA Allianceに 加入しました。TSMC OIP EDA Allianceの メンバーは、TSMCが業界をリードするプロセス技術と3DFabric技術を用い、高品質かつ実績のあるEDAツールとサービスを顧客に提供し、次世代の半導体設計を可能にしています。ジエダットが同アライアンスに加わることの意義と今後の展望について、営業本部 営業企画部長 小野 信任に聞きました。



TSMC OIP EDA Allianceとはどのようなものですか？

TSMCは、台湾に本社を置く巨大な半導体製造メーカーです。高性能コンピューティング、スマートフォン、IoT、自動車、デジタル家電など、さまざまな最終市場をカバーしており、特にAIやスマートフォンなどの最先端半導体ではほぼ独占状態にあります。

OIPは、そのTSMCのIP、設計インプリ、DFM（Design For Manufacture：製造性を考慮した設計）機能、プロセス技術、バックエンドサービスを使用して、半導体設計でのユーザやパートナー企業が相互に情報共有を行い、新たなICを早期に開発できるように、設計から実装までを一括して支える技術基盤です。

EDA AllianceはOIPの 一 部 で、TSMCとEDA Allianceメンバーの研究開発能力とリソースを組み合わせることで、TSMCの技術要件に準拠できるようになります。TSMC OIP EDA AllianceのEDA パートナーは、回路設計のタイミング分析、設計の電気分析のためのシミュレーション、物理的実装の

ための配置配線、物理的レイアウト検証、最終設計テープアウト、サインオフのためのRC抽出など、IC設計におけるニーズのあらゆる段階をカバーするさまざまな設計自動化ツールを提供しています。

TSMC OIP EDA Allianceへの加入にあたり重要なことは何でしたか？

ジエダットは、10年以上にわたりTSMC OIPへの加盟を目指して挑戦を重ねてまいりました。加入にあたって最も重要なポイントは、TSMCの日本ユーザにとって、ジエダットのSX-Meisterがいかに重要か、その必要性を説得することにあります。近年、日本国内にTSMCのユーザが増えたことで、今回、TSMC OIP EDA Allianceへの加入が可能になりました。

ジエダットはTSMC OIP EDA Allianceに加入することで何ができるようになりますか？

ジエダットが同アライアンスに加わることで、ジエダットの主力製品であるSX-Meisterを通じて、TSMCの顧客へのサポートをさらに強化できるよう

になります。TSMC OIP EDA Allianceでは、TSMCの設計技術チームと緊密に連携し、TSMCのロードマップに沿った新しいEDAツール機能の有効化や、リファレンス・フローでのTSMCの設計方法論の実装を通じて、顧客の設計ニーズに対応しています。TSMCのプロセスPDKを使って設計するユーザに対して、TSMCからのテクニカルサポートが可能となることで、迅速かつ安心して利用いただけるようになります。

また、TSMCが例年開催している世界でのOIPセミナーに参加できるようになります。世界のTSMCユーザへTSMCプロセスを使った設計事例などを紹介できるようになり、国内・海外での強力な販促活動が可能となります。

TSMC OIP EDA Allianceへの加入で売り上げの伸長は期待できますか？

国内外のTSMCユーザへの拡販はもちろんですが、これからさらに利用が増えるであろう先端製品の設計にSX-Meisterが対応することで、既存ユーザ・新規ユーザへのさらなる展開が期待されます。

SX-Meisterは、主にアナログ製品、センサー、及び面積・性能を極限まで調整する、大量に製造されるSoCの設計など、通常のデファクトの自動ツールでは困難な設計で利用されます。先端製品の設計は、世界的には海外企業がほぼ独占状態であり、特に海外ではTSMCの製品を使うユーザが非常に多いです。その意味で、現状の大手の製品に満足できていないユーザに選択肢を増やすことで、潜在市場は今のジエダットの実績の10倍以上、長期的には数百億円規模はあると考えております。

TSMC OIP EDA Allianceにおけるジエダットの今後の展望を聞かせてください

TSMCのプロセスは多用で、0.18 μ mから2nmまで幅が広いです。今後、ユーザと連携して対応プロセスの範囲を拡大することで、さらに売上に寄与できると思います。

TSMC OIP EDA Allianceへの加入はそれ自体が目的、ゴールではなく、これで、ジエダットのSX-Meisterを世界のTSMCユーザへ広く届けるためのスタートラインに立つことができたと考えております。TSMC OIP EDA Allianceに参加することで、ジエダットはTSMCと協力し、アナログ、パワーデバイス、メモリ、イメージセンサー、LCDドライバーなど、さまざまなアプリケーションのカスタム設計技術において迅速かつ高品質な対応を可能にし、SX-Meisterの製品力とTSMCの最先端プロセス技術で顧客のイノベーションを加速してまいります。



TSMC 2024 Japan Open Innovation Platform “Ecosystem Forum” ジエダットブースの様子 (2024.10.25)

● 半導体デバイスの需要が低調に推移する中、微増ながらも増収

当事業年度における、当社の主要顧客である半導体を含む電子部品業界では、自動車、産業機械、スマートフォン、パソコン向けの半導体デバイスの需要が（AI関連を除き）低調に推移しました。一方で、AI関連デバイスには高い期待が寄せられており、今後、緩やかながらも各社の在庫調整が進む中で、回復の兆しも見え始めておりました。また、パワー半導体市場においては、EV化の減速感が否めないものの、再生エネルギー、産業機械、民生品などでの需要は依然として高く、各社の設計設備や生産設備への投資は継続されておりました。しかしながら、直近の状況では、アメリカのトランプ政権による関税政策により世界が一変しつつあります。また、対中国政策により日本が強みを持つ半導体関連製品の中国向け輸出規制が強まるきざしも見えており、電子部品業界全体のみならず世界中のあらゆる業界で急速な景気後退感が強まっております。

このような状況の中、当社は産官学との協力を強化し、アナログ半導体向けにAIを用いた設計の自動化に取り組み、設計環境の効率化を追求しており、さらに政府及び自治体が推進している半導体人材育

成にもツールの提供などで貢献しております。2024年6月にはアナログLSIの設計自動化に向けた「ACC (Analog Chip Complier)」の機能拡張版及びパワー半導体の設計分野に向けたツールの機能拡張版をリリースし、同年12月には、主力製品であるSX-MeisterにAIを活用したシミュレーション波形判定ツールを搭載した新製品「SX-Meister SCAI」をリリースしました。また、同年7月には、TSMCのOIP (Open Innovation Platform) EDA Allianceに加入し、同年10月に開催された「OIP Ecosystem Forum」に出展しました。この場で、SX-Meisterを使用したアナログ、イメージセンサー、メモリ等の設計効率向上や、TSMCの最先端プロセス技術によるお客様のイノベーション促進について紹介いたしました。さらに、開発部門の人員増強により、AI関連製品並びに最先端プロセス対応を見据えた開発組織の改編を実施するなど、開発力の強化にも努めております。国内販売促進活動としては、同年9月に、プライベートセミナーを開催し、AI活用による新たなソリューションを紹介するなどの活動も行っております。また、フランスXYALIS社のマスクデータ自動生

成ツール及び同じくフランスPOLLEN社のAIによるプロセス解析・最適化ツールについて国内代理店契約を締結し、製造プロセスといった新たな事業領域へも今後営業活動を積極的に展開しております。海外販売促進活動では、同年12月に中国上海で開催された「ICCAD-Expo 2024」に出展し、アナログLSI設計自動化ツール「ACC」、パワー半導体設計ツール「PowerVolt」及び大規模フォトマスクブラウザ「HOTSCOPE」を紹介することなどで、新市場の開拓を進めております。また、デバイス設計受託サー

ビスにおいては、国内での設計委託需要が引き続き活発であり、業績に順調に貢献しております。

これらの活動の結果、売上高は20億62百万円（前年比0.1%増）となり微増ながらも増収となりました。一方で、営業利益は固定費の増加等により2億56百万円（同14.9%減）となり、経常利益は助成金の減少などの影響もあって2億90百万円（同22.4%減）となりました。当期純利益は、繰延税金資産の取崩し等の影響により2億13百万円（同35.1%減）となりました。

● ソリューション売上高減も、海外向け代理店製品の需要増により製品売上高が増加

製品売上高は11億57百万円（前期比2.8%増）となりました。製品売上高が増加した主な理由は、一時的な需要増によるものと海外向けの代理店製品の需要増によるものです。引き続き、国内外の市場に向けた積極的な営業活動を展開してまいります。

保守サービス売上高は4億17百万円（前期比0.6%減）となりました。保守サービス売上高は若干の減少となりましたが、引き続き、積極的な新機能提案活動

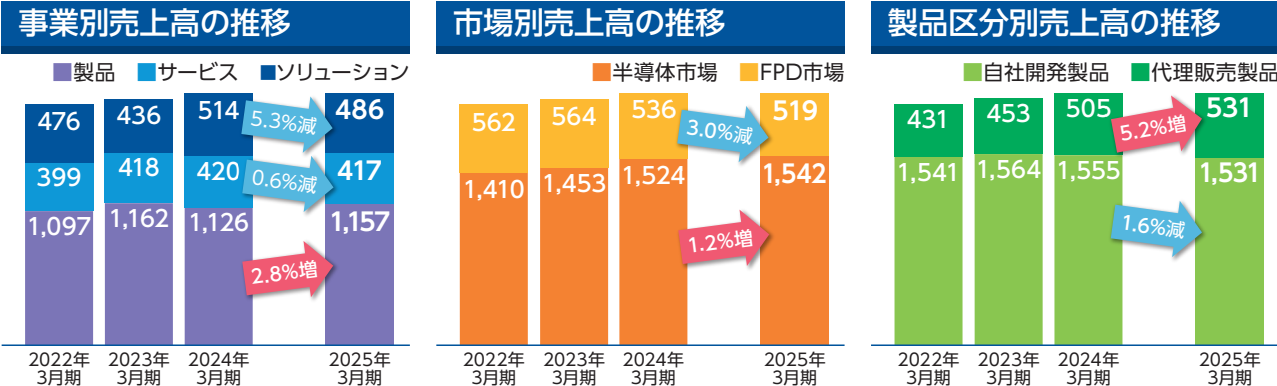
とあわせて保守契約の締結の促進と、顧客ニーズに合わせたサポート・サービスの向上に努めてまいります。

ソリューション売上高（受託開発等）は4億86百万円（前期比5.3%減）となりました。ソリューション売上高が減少した主な理由は、前年度あった大型商談の規模が縮小したことによるもので、引き続き、半導体関連の既存顧客の売上拡大に加えて、新規顧客の開拓を積極的に進めてまいります。

(単位：百万円)

	2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		2025年3月期		
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	対前期比
売上高	1,973	100.0%	2,017	100.0%	2,060	100.0%	2,062	100.0%	+0.1%
売上総利益	1,264	64.1%	1,305	64.7%	1,288	62.5%	1,305	63.3%	+1.4%
販売費及び一般管理費	1,045	53.0%	1,038	51.5%	985	47.8%	1,048	50.8%	+6.4%
営業利益	218	11.1%	267	13.2%	302	14.7%	256	12.5%	△14.9%
経常利益	276	14.0%	317	15.7%	374	18.1%	290	14.1%	△22.4%
当期純利益	169	8.6%	266	13.2%	328	15.9%	213	10.3%	△35.1%

(単位：百万円)



貸借対照表 (単位:千円)

科目	前事業年度 (2024年 3月31日)	当事業年度 (2025年 3月31日)	科目	前事業年度 (2024年 3月31日)	当事業年度 (2025年 3月31日)
資産の部			負債の部		
流動資産	4,198,255	3,107,601	流動負債	977,658	675,407
※ 現金及び預金	3,485,575	2,545,775	買掛金	63,107	56,768
電子記録債権	235,745	219,190	未払金	46,040	21,826
売掛金	418,656	286,544	未払費用	48,154	38,790
仕掛品	2,805	2,029	未払法人税等	49,073	12,312
原材料	4,373	603	前受金	637,084	441,958
前渡金	9,740	23,854	預り金	17,664	9,530
前払費用	37,086	25,144	賞与引当金	106,859	94,220
その他	4,273	4,459	その他	9,674	—
固定資産	317,913	1,165,771	固定負債	3,700	3,700
有形固定資産	22,684	22,701	資産除去債務	3,700	3,700
無形固定資産	18,032	14,589	負債合計	981,358	679,107
投資その他の資産	277,196	1,128,480	純資産の部		
投資有価証券	138,567	132,121	株主資本	3,534,810	3,594,265
長期前払費用	667	2,570	資本金	762,524	762,524
繰延税金資産	99,033	56,639	資本剰余金	893,443	893,443
※ 長期預金	—	900,000	利益剰余金	1,907,482	1,966,937
その他	38,927	37,148	自己株式	△28,639	△28,639
資産合計	4,516,169	4,273,372	純資産合計	3,534,810	3,594,265
			負債純資産合計	4,516,169	4,273,372

※ 前事業年度のキャッシュ・フロー計算書「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表「現金及び預金」との差異は、主に預入期間3ヶ月を超える定期預金9億円等によるものであります。当事業年度は、9億円を長期預金としたためキャッシュ・フロー計算書「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表「現金及び預金」との差異はございません。

損益計算書 (単位:千円)

科目	前事業年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
売上高	2,060,890	2,062,768
売上原価	772,769	757,033
売上総利益	1,288,121	1,305,735
販売費及び一般管理費	985,968	1,048,744
営業利益	302,152	256,990
営業外収益	74,213	42,019
営業外費用	2,328	8,935
経常利益	374,037	290,075
税引前当期純利益	374,037	290,075
法人税、住民税及び事業税	63,441	34,252
法人税等調整額	△18,092	42,394
当期純利益	328,688	213,428

株主資本等変動計算書 (単位:千円)

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

	株主資本								純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	
		資本 準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計			
2024年 4 月 1 日残高	762,524	893,075	368	893,443	1,907,482	1,907,482	△28,639	3,534,810	3,534,810
当期変動額									
剰余金の配当					△153,973	△153,973		△153,973	△153,973
当期純利益					213,428	213,428		213,428	213,428
当期変動額合計	—	—	—	—	59,455	59,455	—	59,455	59,455
2025年 3 月31日残高	762,524	893,075	368	893,443	1,966,937	1,966,937	△28,639	3,594,265	3,594,265

● 仏 XYALIS, sarlと国内販売代理契約を締結

2024年5月、ジーダットは、先進的な半導体マスク設計自動化ソフトウェアを提供する XYALIS, sarlと販売代理店契約を締結しました。XYALIS社は、設計完了後から製造に至る過程である MDP（Mask Data Preparation）分野において自動化ソフトウェアを提供する専業ベンダです。ヨーロッパ、アジア、米国にて多くの実績があり、豊富な経験を活かしてお客様の既存環境の課題や改善点を速やかに把握し、より高度なMDP環境へスムーズに移行することが可能です。

この提携により、ジーダットは、国内における半導体マスク分野のお客様に対して、高度な自動化手法と高品質なソリューションを提供することで、より充実した半導体開発支援体制を実現できるようになります。

● ジーダット、SAGAハイスクールDI人材育成プログラムに自社開発ツールを提供

2024年6月、ジーダットは、佐賀県教育委員会、佐賀県が創設したDI人材育成事業『SAGAハイスクールDI人材育成プログラム「SEIRENKATA」』*の柱の一つである「サーキットデザイン教育」のため、受講する高校生に向けて当社自社開発製品であるSX-Meisterの提供を開始いたしました。今回のジーダットの取り組みは、日本における深刻な半導体設計人材の不足に対応するべく開始した、高等専門学校等における半導体設計人材の育成プログラム：「サーキットデザイン教育の全国展開」の支援の一環となります。全国の高等専門学校等を対象として、ジーダットの主力製品である半導体設計用CADシステムを提供して、半導体設計人材の育成を支援するものです。

※『SAGAハイスクールDI人材育成プログラム「SEIRENKATA」』は、幕末日本の科学技術の発展に大きな功績を遺した精煉方（佐賀藩が1852年に設けた理化学研究所）になぞらえ、令和版ハイスクール人材育成事業を「SEIRENKATA」と名付け、立ち上げたものとなります。

● 仏 POLLEN METROLOGYと国内販売代理契約を締結

2024年8月、ジーダットは、半導体製造の市場投入までの時間を短縮する総合的なAI駆動型プロセス制御プラットフォーム：Smart3を提供するPOLLEN METROLOGYと販売代理店契約を締結しました。POLLEN社は2014年にフランスで設立、計測と検査の画像ベースのデータ分析に重点を置いたSmart3を10年以上開発、米国、アジア、ヨーロッパの優良顧客に事業を展開し、微細な画像解析による歩留まり低下の根本原因の特定を加速しています。

この提携により、ジーダットは国内における半導体製造分野のお客様に対して、POLLEN社のSmart3を提供することで、開発及び製造プロセスに関連する複雑なデータの分析を自動化することができ、新しい半導体プロセスの市場投入までの時間短縮を実現できるようになります。

● アナログ半導体設計向けにAI技術を搭載した波形判定ツールを開発

2024年11月、ジーダットは、東芝情報システム株式会社が開発した波形特性自動判定ツール Waveform meisterの使用に関するライセンス契約を締結し、アナログ半導体設計向け新製品としてAI波形判定ツール SX-Meister SCAI（SpiceChartAI）を開発しました。

アナログ半導体設計の多岐にわたるシミュレーション結果の波形判定においては、測定結果が仕様を満たしていても、波形全体をみたときに異常な波形が検出される場合があります。このような異常波形の検出は目視で行わざるを得ませんでした。SX-Meister SCAI（SpiceChartAI）は、Waveform meisterのAI技術を取り入れ、自動でアナログ半導体設計における大量の波形判定を行います。異常波形をAIで判定するので、目視によるミスをなくし、設計の早期段階で手戻りを無くすことで設計期間を短縮し設計品質も大幅に向上させます。2024年12月リリースのSX-MeisterVer.18.0にて販売を開始しております。

● 公式YouTubeチャンネルのお知らせ

ジーダットは公式YouTubeチャンネルにて決算説明動画などを配信しております。当社についてさらにご理解を深めていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお祈いします。



https://www.youtube.com/@JEDAT_Official

(2025年6月18日現在)

会社概要	
商 号	株式会社ジーダット（Jedat Inc.）
所 在 地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
代 表 者	代表取締役社長 松尾 和利
営 業 開 始	2004年2月2日
資 本 金	762,524,260円（2025年3月31日現在）
事 業 内 容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション・半導体集積回路の設計受託

役 員	
代 表 取 締 役	松尾 和利
取 締 役	小川 尚史
取 締 役	藤澤 義麿
取 締 役	長谷部 邦雄
社 外 取 締 役	佐上 達男
社 外 取 締 役	渥美 滋
社外監査役(常勤)	小松 弘明
監 査 役	小川 泰
社 外 監 査 役	日比野 好恵

一部訂正について

文中に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたしました。
本資料は修正後です。

修正箇所 4ページ

訂正内容 訂正前：TSMCのプロセスは多用で、0.18nmから2nmまで幅が広いです。
訂正後：TSMCのプロセスは多用で、0.18μmから2nmまで幅が広いです。